

目 录

.....	1
.....	1
.....	1
.....	2
.....	2
1. 仪器仪表的选择与使用	2
2. 电子元器件的识别和检测	2
3. 电子工程图的识读	3
4. 常用装配工具的选择与使用	3
5. 电子产品工艺文件的使用	4
6. 电子元器件的预处理与插装	4
7. 电子线路的手工焊接	5
8. 电子产品的电路调试	6
9. 电子产品的电路故障检修	6
10. 电子产品装配质量检验	7
.....	9
1. 硬件电路的手工装配	9
2. 硬件电路调试	9
3. 仪器仪表选择和操作	10
4. 常用工具软件的使用	11
5. 工艺文件编写	11
6. 程序代码编写	12
.....	13
.....	13
1. 电子元器件的识别和测试	13
2. 仪器仪表的选择与使用	14
3. 电子工程图的识读	14
4. 程序代码编写	15
5. 嵌入式系统综合调试与测试	15
.....	17
1. 移动应用开发环境搭建	17
2. 移动应用 UI 设计	17
3. 移动应用人机交互设计	18
4. 移动应用程序代码编写	19
5. 移动应用程序综合调试	19
.....	21
1	21
2	21
3	21

	25
1	25
2	25
3	26
	26

610115

1. 仪器仪表的选择与使用

2. 电子元器件的识别和检测

3. 电子工程图的识读

4. 常用装配工具的选择与使用

5. 电子产品工艺文件的使用

6. 电子元器件的预处理与插装

7. 电子线路的手工焊接

8. 电子产品的电路调试

9. 电子产品的电路故障检修

10. 电子产品装配质量检验

1. 硬件电路的手工装配

13—Žá?ô93 ú6| J3P «?±"r

3. 仪器仪表选择和操作

4. 常用工具软件的使用

5. 工艺文件编写

6 程序代码编写

1. 电子元器件的识别和测试

2. 仪器仪表的选择与使用

3. 电子工程图的识读

4. 程序代码编写

5. 嵌入式系统综合调试与测试

1. 移动应用开发环境搭建

2. 移动应用 UI 设计

3. 移动应用人机交互设计

4. 移动应用程序代码编写

5. 移动应用程序综合调试

1



			0
		6S	

			0
		6S	



3

2

表 2 考核内容与考核方式

					()
					180
					180
		STM32	STM32		120
		AndroidStudio	AndroidStudio		120